



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7497.2—2008/IEC 60796-2:1990  
代替 GB/T 7497.2—1987

## 微处理器系统总线 8 位及 16 位数据 (MULTIBUS I) 第 2 部分:对带有边缘连接器 (直接配合) 的系统总线配置的机械与引脚的描述

Microprocessor system bus—8-bit and 16-bit data (MULTIBUS I)—  
Part 2: Mechanical and pin descriptions for the system bus  
configuration with edge connectors (direct)

(IEC 60796-2:1990, IDT)

2008-08-06 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 目的 .....	1
3 底板的设计依据 .....	1
3.1 板间关系 .....	1
3.2 系统总线引脚分配 .....	2
3.3 总线连接器 .....	2
4 形状因子 .....	3
4.1 连接器命名与引脚编号标准 .....	3
4.2 印制布线板的标准外形 .....	3

## 前 言

GB/T 7497《微处理器系统总线 8 位及 16 位数据(MULTIBUS I)》分为以下三个部分:

- 第 1 部分:电气与定时规范的功能描述;
- 第 2 部分:对带有边缘连接器(直接配合)的系统总线配置的机械与引脚的描述;
- 第 3 部分:对带有插针与插座连接器(间接配合)的欧洲板配置的机械与插针的描述。

本部分是 GB/T 7497 的第 2 部分,等同采用 IEC 60796-2:1990《微处理器系统总线 8 位及 16 位数据(MULTIBUS I) 第 2 部分:对带有边缘连接器(直接配合)的系统总线配置的机械与引脚的描述》。

本部分还对 IEC 60796-2:1990 做了下列编辑性修改:

- 删去了 IEC 60791-2 的“前言”;
- 增加了国家标准前言。

本部分代替 GB/T 7497.2—1987《微处理机系统总线 I 8 位及 16 位数据 第二部分:采用边缘连接器(直接配合)作为系统总线配置的机械及插针的说明》。

本部分对 GB/T 7497.2—1987 做了下列主要修改:

- 名称由《微处理机系统总线 I 8 位及 16 位数据 第二部分:采用边缘连接器(直接配合)作为系统总线配置的机械及插针的说明》改为《微处理器系统总线 8 位及 16 位数据(MULTIBUS I) 第 2 部分:对带有边缘连接器(直接配合)的系统总线配置的机械与引脚的描述》;
- 文本的文字改动。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本部分起草单位:中国电子工业部标准化研究所。

本部分主要起草人:高健、匡常山、魏述艳、张贻南。

本部分首次发布于 1987 年,本次为第一次修订。

## 引 言

GB/T 7497 包括三个部分：一份功能描述及两个可供选用的机械标准。本标准涉及让各种微处理器系统部件彼此交互作用的电气与机械接口。接口总线用作紧耦合系统部件之间的并行传送和适用信号的互连。

# 微处理器系统总线

## 8 位及 16 位数据(MULTIBUS I)

### 第 2 部分:对带有边缘连接器(直接配合) 的系统总线配置的机械与引脚的描述

#### 1 范围

GB/T 7497 的本部分适用于借助边缘连接器(直接配合)类型的底板来连接微处理器系统各部件的接口。

#### 2 目的

GB/T 7497 的本部分旨在描述设计者在设计底板或准备插入本系统总线接口的印制电路板时应予关心的物理上的与机械上的全部规范。所有尺寸均以毫米标注,括号内附注的英寸数字仅供参考(以毫米数字为准)。

#### 3 底板的设计依据

连接各模块的底板,最大长度为 457.2 mm(18 in)。在系统内使用底板扩展板总线不予支持,除非将扩展板包括在内的总线总长小于最大长度 457.2 mm。

##### 3.1 板间关系

当设计板间距为 15.3 mm(0.6 in)的兼容电路板时,应遵循以下印制电路板规范:

a) 板的间距( $L_C$ )

当插入底板时,电路板的中心距应至少为 15.24 mm±0.51 mm(0.6 in±0.02 in)。

b) 板的厚度( $L_T$ )

电路板的典型厚度是 1.575 mm±0.127 mm(0.062 in±0.005 in)。

c) 元器件引线长度( $L_L$ )

印制电路板之下的元器件引线不能超过 2.362 mm(0.093 in)。

d) 元器件高度( $L_H$ ):在印制电路板之上的元器件的最大高度,利用以下公式确定。

$$L_H < L_C - L_T - L_L$$

$$L_H < 14.732 \text{ mm} - 1.702 \text{ mm} - 2.362 \text{ mm} (0.58 \text{ in} - 0.067 \text{ in} - 0.093 \text{ in})$$

$$L_H < 10.67 \text{ mm} (0.420 \text{ in}) \text{ (包括板的翘曲量)}。$$

对导电的元器件,要求将其  $L_H$  减少到 10.16 mm(0.40 in)。

底板插件之间的分隔如图 1 所示。

典型底板和实现此种底板所必要的元器件的例子如图 2 所示。

本部分只包括设计系统总线接口的机械性能规范,设计者还应考虑 GB/T 7497.1—2008 第 3 章中的电气性能规范。